

California Micro Devices collabore avec SPEL Semiconductor pour créer deux lignes de montage de paquets moulés sans fil. L'investissement mixte devrait s'élever à 7,75 millions de dollars

- Les nouvelles lignes devraient être qualifiées et devenir opérationnelles au cours des deux prochains trimestres

MILPITAS (Californie), 24 janvier /PRNewswire-FirstCall/ -- California Micro Devices (cotée au Nasdaq sous le symbole CAMD) vient d'annoncer aujourd'hui qu'elle a conclu un accord avec SPEL Semiconductor qui vise à étendre la capacité des lignes de montage de paquets moulés sans fil (LMP) de SPEL afin de permettre la prise en charge de deux nouveaux paquets à profil réduit supplémentaires. California Micro Devices apportera une contribution d'environ 2,2 millions de dollars américains dans l'investissement mixte total, estimé à 7,75 millions de dollars, qui sera nécessaire pour l'extension de la capacité afin de pouvoir prendre en charge les deux lignes de montage supplémentaires.

Avec la popularité croissante des téléphones portables à profil plat et d'autres appareils portables de taille réduite comme les lecteurs multimédia portables, les lecteurs MP3 et les appareils photos numériques et autres caméscopes, la demande auprès de la société pour des produits de protection des appareils portables conditionnés dans des paquets sans fils à profil réduit a considérablement augmenté. L'accord avec SPEL offre à California Micro Devices une expansion importante et rentable de sa capacité d'assemblage étant donné qu'il augmente sa pénétration dans ce segment en croissance du marché de la protection des appareils portables. Les deux nouvelles lignes de montage fourniront des capacités d'assemblage pour les produits de la société qui utilisent les paquets TLMP et uTLMP.

« La technologie et les capacités de production de SPEL sont complémentaires de notre stratégie de conditionnement de nos produits de protection des téléphones portables dans les tailles les plus réduites et les profils les plus plats » a indiqué Robert V. Dickinson, président-directeur général de CMD. « Nous nous réjouissons d'accroître notre relation avec SPEL et de collaborer avec eux pour lancer les nouvelles lignes de montage de LMP dès cette année. »

A propos de SPEL Semiconductor Limited

SPEL Semiconductor Limited est le centre de sous-traitance, clé en main et complet, leader en Inde du tri des plaquettes, de l'assemblage et des tests de circuits intégrés. SPEL, société fondée en 1988 et sise à Chennai, a servi le marché local de 1988 à 1994. Après avoir établi un beau palmarès national, SPEL a tourné son attention vers les marchés mondiaux plus exigeants en 1995. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'elle dessert la Silicon Valley ainsi que d'autres régions du monde. Pour en savoir plus, consultez www.spel.com.

A propos de California Micro Devices Corporation

California Micro Devices Corporation est un important fournisseur de semi-conducteurs analogiques et à signaux mixtes à application spécifique destinés aux marchés des téléphones portables, des ordinateurs personnels et de l'électronique numérique grand public. Les produits clés comprennent les dispositifs de protection pour les téléphones portables, les produits électroniques numériques grand public tels que les téléviseurs numériques et les ordinateurs personnels ainsi que les circuits intégrés analogiques et à signaux mixtes pour les écrans de téléphones portables. Pour en savoir plus sur la société et ses produits, veuillez consulter le site Web www.cmd.com.

Tous les énoncés contenus dans ce communiqué autres que les faits historiques sont des énoncés prospectifs formulés conformément aux dispositions de la règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ils ne garantissent aucunement la performance ou les événements futurs. Au contraire, ils sont basés sur des attentes, des estimations, des croyances, des hypothèses, et des objectifs et sont assujettis à des incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, nos résultats réels sont susceptibles de varier sensiblement de ces énoncés. Ces énoncés sont souvent identifiables par des termes tels que, envisage, s'attend à ce que, projette, croit, anticipe, estime, ainsi que par l'emploi du futur. Parmi les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué de presse, on peut citer les suivants : le coût de l'extension de capacité de SPEL sera d'environ 7,75 millions de dollars ; la Société augmentera la pénétration de ses dispositifs de protection des appareils portables sur les marchés des téléphones portables à profil plat

et d'autres appareils portables de taille réduite ; SPEL réussira à mettre en place ses deux lignes de montage et elles se qualifieront et seront opérationnelles au cours des deux prochains trimestres ; SPEL sera un producteur rentable de paquets TLMP et uTLMP ; enfin, la stratégie de la Société qui consiste à conditionner ses produits de protection des appareils portables dans les tailles les plus réduites et les profils les plus plats. Ces énoncés prospectifs sont basés sur nos hypothèses sur l'avenir et notre évaluation du futur, qui pourront ou non s'avérer correctes, et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes y compris, mais de manière non limitative, la possibilité que les lignes de montage de LMP de SPEL nécessiteront des équipements plus onéreux que ceux qui ont été estimés ou que leur construction générera des dépassements de budget ; la question de savoir si la performance du concept de nos dispositifs de protection des appareils portables répondra aux exigences de nos clients de sorte qu'ils continuent à utiliser nos dispositifs dans la conception de leurs produits ; la question de savoir si nos dispositifs se conforment aux spécifications de construction ; la question de savoir si un concurrent introduit des dispositifs à des prix inférieurs aux nôtres nous faisant ainsi perdre des parts de marché ; la question de savoir si SPEL rencontrera des difficultés liées à la main d'œuvre, aux autorisations gouvernementales ou aux financements qui pourraient retarder ou empêcher la réalisation de ses lignes de montage ; la question de savoir si SPEL rencontrera des coûts ou dépenses inattendues ou des difficultés techniques qui font qu'elle n'est pas un producteur de paquet rentable ; et la question de savoir si nous rencontrons des problèmes de conception ou que SPEL rencontre des difficultés techniques dans le conditionnement de nos produits dans des tailles réduites et dans des profils les plus plats ainsi que les facteurs de risque énumérés dans les formulaires 8K, 10K et 10Q déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Étant donné ces risques ainsi que d'autres, les résultats réels futurs de la société pourront varier sensiblement de ceux mentionnés ci-dessus. Ces énoncés prospectifs ne sont valides qu'à la date de ce communiqué, et, sauf si la loi l'exigeait, nous ne nous engageons aucunement à publier des mises à jour ni aucune révision de ces énoncés, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs, ou autrement.

Site Web: <http://www.calmicro.com>
<http://www.spel.com/>

SOURCE : California Micro Devices Corporation

Kevin Berry, directeur financier de California Micro Devices, +1-408-934-3144, ou kevinb@cmd.com